



リセプタクルハウジング外形
OUTLINE OF RECEPTACLE HSG.

推奨基板取付け寸法 (非累積公差)
RECOMEND PC BOARD HOLE (NOT ACCUMULATE TOLERANCE)
PC BOARD THICKNESS; 1.6 ± 0.1
基板厚; 1.6 ± 0.1

- 注記
- 1 材料; 熱可塑性ポリエステル樹脂 (ガラス入り)
色; 黒
 - 2 製品規格; 108-5349
 - 3 製品認定報告書; 501-5013
 - △ 接触部仕上; ニッケル下地 0.38 μMIN. 金メッキ
 - △ 接触部仕上; ニッケル下地 0.76 μMIN. 金メッキ
 - △ 接触部仕上; ニッケル下地 2.0 μMIN. スズメッキ
 - △ レグおよび脚部仕上; ニッケル下地半田メッキ
 - △ 6箇所マーキング; 白
 - △ レグおよび脚部仕上; ニッケル下地スズメッキ

- NOTES
- 1 MATERIAL; GLASS FIELD THERMO PLASTIC, POLYESTER.
COLOR; BLACK
 - 2 PRODUCT SPEC; 108-5349
 - 3 QUALIFICATION TEST REPORT; 501-5013
 - △ FINISH (CONTACT AREA); 0.38 μMIN. GOLD PLT. OVER NICKL.
 - △ FINISH (CONTACT AREA); 0.76 μMIN. GOLD PLT. OVER NICKL.
 - △ FINISH (CONTACT); 2.0 μMIN. TIN PLT. OVER NICKEL.
 - △ FINISH (RETENTION LEG AND CONTACT TAIL); TIN-LEAD PLT. OVER NICKEL.
 - △ 6 PLACES MARKING; WHITE
 - △ FINISH (RETENTION LEG AND CONTACT TAIL); TIN PLT. OVER NICKEL.

PRINT DIST

METRIC

AMP-J
REV.10/83

△9 △4	3-175365-2	△8
△9 △4	1-175365-2	△8
△9 △6	-5	
△9 △5	-3	
△9 △4	175365-2	
FINISH	型番 PART NUMBER	マーキング MARKING

F	REVISED FJD0-0039-03	TS	S.M.	9/21/92
E	REVISED FJD0-0114-03	TS	SM	25 APR '03
D	REVISED FJ00-1298-98	MH	NM	9/21/98
C	REVISED FJ00-5288-96	NM	Y.I.	9/19/96
B	REVISED FJ00-4592-96	K.I.	Y.I.	5/8/96
A	REVISED FJ00-0395-93	TY	SM	5/18/93
O	RELEASED (J-0406)	TY	SM	3/18/92
LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE

Copyright ©1992 年 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.		Copyright ©1992 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.		Tyco Electronics AMP K.K. Kawasaki, Japan	
適合電線径範囲 (WIRE RANGE) mm ² (AWG -)		被覆外径 (INSULATION DIA.) mm ^φ		名称 (NAME) DYNAMIC (D-3500) 20 POS. HDR. ASS'Y	
材料 (MATERIAL) (SEE NOTE) 注記参照		仕上 (FINISH)		一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 10mm以下: ±0.2 10mm超30mm以下: ±0.25 30mm超100mm以下: ±0.3 角公差: ±0.3	
DR. 3/18/92 T-YONEBAYASHI		DE. 3/18/92 T-YONEBAYASHI		LOC A3 J	
CHK. S.MANABE		APP. S.MANABE		REV. F	
SHEET		SHEET		SHEET	